



模具數位輔助設計體驗營

政府自 2016 年開始推動「數位國家、創新經濟」方案至今，眾多製造業者開始重視數位轉型可帶來的具體效益，並探討如何運用數位化設計與分析技術，促進傳統產業之轉型升級。

從模具業產業趨勢來看，由於產品生命週期愈來愈短、少量多樣之客製化產品需求增加，因此在經濟部技術處支持下，金屬中心執行「模具產業鏈整體數位轉型關鍵技術開發計畫」，完成鑄造與鍛造模具數位輔助設計系統開發。

本體驗營活動目的在推廣此系統，期藉由此系統的展開，協助中小企業業者縮短產品開發所需之模具設計及製造時程，業者可藉此達到快速設計、減少開發時程與修模成本，提升企業競爭力。

指導單位： **DOIT 經濟部技術處** 經濟部技術處
Ministry of Economic Affairs

主辦單位： 財團法人金屬工業研究發展中心

協辦單位：實威國際股份有限公司、國立台灣科技大學、國立中興大學、國立高雄科技大學

會議資訊：

■時 間：<第一場次>112 年 07 月 19 日 (三)

<第二場次>112 年 07 月 26 日 (三)

<第三場次>112 年 08 月 02 日 (三)

■地 點：<第一場次>國立中興大學 工學院 應用科技大樓 5 樓 531 電腦教室

<第二場次>國立高雄科技大學-第一校區 智慧製造實作工場 2 樓 T212

<第三場次>國立臺灣科技大學 機械工程系 工程一館 2 樓 E1-223

■費 用：免費(名額有限，額滿為止)

■建議參加對象：

1. 鑄造、鍛造等傳統製程業者
2. 對數位輔設計、電腦模擬設計分析、智慧製造有興趣之各界人士

議程：

時間	議程/主題	主講人
12:30-13:10	報 到	
13:10-13:15	長官致詞	金屬工業研究發展中心 林英傑 主任
13:15-14:15	鑄造數位輔助介紹與實機操作體驗	金屬工業研究發展中心 洪啟銘 專案經理
14:15-14:45	SOLIDWORKS 數位設計平台新趨勢	實威國際股份有限公司 江韋有 業務經理<第一場次> 林毅弘 業務經理<第二場次> 彭聖介 工程副總<第三場次>
14:45-15:00	中間休息(大合照)	
15:00-16:00	鍛造數位輔助介紹與實機操作體驗	金屬工業研究發展中心 許家豪 專案經理
16:00-	賦歸(餐盒領取)	

*若因不可預測突發因素，大會擁有議程及講師變更權力

中興大學電腦教室位置圖：



2021.10.27 修訂

高科大第一校區電腦教室位置圖：



台灣科技大學電腦教室位置圖：



報名辦法

1. 因電腦教室有設備限制，不開放現場報名入場
2. 報名辦法：
 - (1) E-mail 報名：填妥報名表格後請寄到 chaoi@mail.mirdc.org.tw
 - (2) 傳真報名：填妥報名表格後請傳真到 (07) 353-3978
 - (3) 網路報名：請上金屬中心網站登錄報名資訊
<https://www.mirdc.org.tw/ProseminarView.aspx?Cond=11414>
 - (4) 報名時間：即日起至 112 年 07 月 12 日止
 - (5) 洽詢電話：吳小姐 (07) 351-3121 #2380

報名表

模具數位體驗營		報名日期	年 月 日
		☐ 第一場次 ☐ 第二場次 ☐ 第三場次	
姓 名	職 稱	* E-MAIL	
* 公司名稱		* 公司電話	
公司地址：			
* 聯 絡 人		* 手 機	
請問您是透過何處得知活動訊息(請勾選)		有 * 記號之欄位務必填寫， 以利報名確認及日後的活動訊息通知。 * 本表如不敷使用，請自行影印，謝謝！	
☐ 傳真 ☐ 網站			
☐ 金屬前鋒報			
☐ 郵寄 ☐ 公學協會			
☐ 軟體商 ☐ 其它			

財團法人金屬工業研究發展中心

個人資料蒐集、處理、利用告知暨同意書

本中心辦理模具數位輔助設計體驗營之事由，蒐集、處理及利用您所提供，或未來將提供的個人資料，茲依據個人資料保護法（以下稱個資法）第8條規定告知下列事項：

(一)蒐集目的：辦理本次活動及相關行政管理。

(二)個資類別：辨識個人者如姓名、職稱、聯絡方式、地址等。

現行之受僱情形如公司名稱、部門、職稱等。

(三)利用期間：至蒐集目的消失為止。

(四)利用地區：除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本中心僅於中華民國領域內利用您的個人資料。

(五)利用對象及方式：於蒐集目的之必要範圍內，利用您的個人資料。

(六)當事人權利：您可向本中心「個資當事人權利行使窗口」行使查詢或請求閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理利用或刪除您的個人資料之權利，電話：07-3513121 轉 2360

(七)不同意之權益影響：若您不同意提供個人資料，本中心將無法為您提供特定目的之相關服務。

本人已閱讀並了解上述之告知事項，並同意 貴中心在符合上述告知事項範圍內蒐集、處理及利用本人個人資料。

立書人簽名：

日 期： 年 月 日